

2026（第7届）抗菌科学与技术论坛

第二轮会议通知

各企事业单位：

抗菌科学与技术论坛是抗菌领域最具知名度和影响力的年度学术大会。作为展示学术成果、交流学术思想、创新学术观点的平台，2026（第7届）抗菌科学与技术论坛由中关村汇智抗菌新材料产业技术创新联盟、西北工业大学共同主办，将于2026年11月20日-22日在西安举行。本次大会以“十五五”精神为指引，以科技自立自强为目标，以“创新技术、发展新材料、推动新增长”为主题，通过大会报告、分会场、墙报、论文摘要集等多种形式展示最新抗菌科学研究进展，并以现场展位形式介绍最新抗菌技术、产品和仪器装备等，以增进学术交流，促进抗菌科学创新与技术发展。

欢迎国内外从事抗菌相关科学研究、技术开发、产品制造、性能评价等的专家、学者、工程技术人员、在校学生踊跃投稿，积极参加会议交流。

一. 主办单位

中关村汇智抗菌新材料产业技术创新联盟
西北工业大学

二. 时间地点

会议时间：2026年11月20日-22日（20日报到）

会议地点：西安豪享来温德姆至尊酒店（陕西省西安市雁塔区慈恩东路208号）

三. 组织机构

（一）大会顾问（以姓氏拼音为序）

陈学思 迟力峰 付小兵 顾 宁 侯立安 彭孝军 任露泉 沈建忠 施剑林
孙大文 唐本忠 王迎军 吴清平 阎锡蕴 杨义燕 赵进才

（二）大会主席（以姓氏拼音为序）

黄 维 朱美芳

（三）学术委员会（以姓氏拼音为序）

陈仕国 陈守刚 陈运法 程 冲 程义云 丁 丹 丁 鑫 董阿力德尔图
杜建忠 段 顺 高长有 高 辉 高利增 郭东升 胡进明 计 剑 姜兴茂
姜雪峰 蒋兴宇 李建树 李莉莉 李 鹏 林宝凤 林 翰 刘惠玉 刘平生
刘润辉 刘宣勇 鲁振坦 栾世方 冒海蕾 宁成云 牛忠伟 戚震辉 曲晓刚
饶静一 任学宏 史林启 谭 鸿 陶友华 王佰亮 王 东 王 浩 王怀雨
王 荣 王 树 王小磊 王小英 王 兴 王亚培 吴富根 吴水林 相恒学
谢小保 熊梦华 徐大可 徐福建 徐立群 严 锋 闫学海 杨春光 杨大鹏
杨 鹏 叶俊伟 于 谦 袁 勋 张 彬 张 雷 赵伟锋 郑裕东 郑玉峰
周冬生 周祚万 朱 奎

（四）秘书长（以姓氏拼音为序）

李 鹏 王 兴 张迎增

四. 大会形式

(一) 大会报告(更新中……)

唐本忠、侯立安、黄维、王迎军、朱美芳、顾宁等院士将莅临大会，主持或者进行大会报告。

(二) 分会场

本次大会拟设立以下分会场：

(01) 抗菌表界面分会场：专注于抗菌材料的表面、微观结构、接合界面及其抗菌机理的理论研究及应用

- 主 席：蔡开勇 张 雷 段 顺
- 联系人：袁 璋 (yuanzhang1993@nwpu.edu.cn)

(02) 金属抗菌材料分会场：专注于金属抗菌材料抗菌理论及应用研究

- 主 席：吴水林 憨 勇 徐大可
- 联系人：周文昊 (zhouwh@c-nin.com)

(03) 无机抗菌材料分会场：专注于非金属低维碳材料相关的无机抗菌材料与纳米抗菌材料及其抗菌理论和应用研究

- 主 席：刘惠玉 高利增 屈 雪
- 联系人：韩阿龙 (17356745885@163.com)

(04) 高分子抗菌材料分会场：专注于生物大分子(抗菌肽、壳聚糖、蛋白等)、有机高分子抗菌材料理论及应用研究

- 主 席：高长有 史林启 徐福建
- 联系人：王腾蛟 (iamtjwang@nwpu.edu.cn)

(05) 新型抗菌材料分会场：专注于新型及复合抗菌材料理论及应用研究

- 主 席：曲晓刚 严 锋 程义云
- 联系人：刘立志 (lizhi.liu@nwpu.edu.cn)

(06) 农业和食品分会场：专注于农蓄、果蔬、食品等产业的抗菌技术与材料的理论及应用研究

- 主 席：王亚培 杨 鹏
- 联系人：孔 佳 (kongjia@snnu.edu.cn)

(07) 光电和智能材料分会场：专注于光电和智能抗菌材料的理论及应用研究

- 主 席：汪联辉 李 鹏
- 联系人：贾庆岩 (iamqyjia@nwpu.edu.cn)

(08) 感染性疾病诊疗与防控分会场：专注于致病微生物引发的感染性疾病诊断与防控

- 主 席：周冬生 李 锋
- 联系人：黄晓楠 (1251585584@qq.com)

(09) 产学研分会场：交流科学研究、技术开发、产业化到市场应用

- 主 席：栾世方 王云兵
- 联系人：石恒冲（shihc@ciac.ac.cn）

(10) 青年学者分会场：面向博士后、年轻讲师，或者文章成果突出的博士研究生设立，为学术新人提供介绍研究方向、展示研究成果和开展学术交流的机会

- 主 席：李国锋 王腾蛟
- 联系人：张桢焱（iamzyzhang@nwpu.edu.cn）

(三) 墙报展示

大会现场设立墙报展示区域。墙报按照大会内容进行主题设置并张贴。

注：墙报作者需自行制作墙报并带到会场。墙报规格为宽 90cm×高 120cm，模版见附件 2。

(四) 现场展览

大会现场设立展区，展示抗菌相关期刊杂志，以及新产品、新仪器装备等。

(五) 会议奖项

大会由上海润河纳米材料科技有限公司支持，设立“**优秀青年学者报告奖**”、“**优秀墙报奖**”、“**优秀组织奖**”等三个奖项，并在大会闭幕式进行颁奖。

五. 大会征文

会议论文投稿将分为论文集、墙报交流、口头报告。征文截稿日期：2026 年 10 月 10 日，请登录会议报名系统注册及投稿。

(一) 征文内容，包括但不限于以下方面：

(01) 抗菌材料的表面、微观结构、接合界面及其抗菌机理的理论研究及应用。

(02) 抗菌材料，包括但不限于银、锌、铜、钛、金等金属元素或非金属低维碳材料相关的无机抗菌材料，生物大分子（抗菌肽、壳聚糖、蛋白等）、有机高分子抗菌材料，纳米抗菌材料，以及新型和复合抗菌材料的理论及应用研究。

(03) 抗菌材料与微生物、抗菌检测与抗菌性能评价新理论、新方法。

(04) 微生物（特别是耐药菌）的基本理论与发现、院内感染防控与耐药菌的治疗研究。

(05) 其他，包括但不限于抗菌、防霉、抗病毒、防螨等相关的技术理论、技术、材料与应用研究

(二) 论文摘要提交

论文请根据论文摘要模板（见附件 1）撰写，并应符合以下要求：

(1) 摘要应符合大会内容，符合国家及各单位保密规定，文责自负。

(2) 摘要应扼要表述研究背景、目的、实验方法、数据结果、主要论点和结论。

(3) 摘要应按大会内容进行投稿，并选择合适的交流形式（口头报告、墙报展讲、论文集汇编）。

六. 参会须知

(一) 会议报名

会议已开通在线报名功能，请扫描二维码，进行会议报名，大会口头报告、墙报

和论文摘要集申请，会议缴费，酒店预定：



注：大会口头报告、墙报和论文摘要集**申请开放至 10 月 10 日**。请于该日期前进行提交。大会将于 **10 月 31 日前确定口头报告、墙报和论文摘要集录用情况**并发放录用通知。

(二) 参会费用

(1) 费用标准

费用标准 参会类型	优惠注册费	标准注册费
	10 月 15 日及之前	10 月 15 日之后
学生（凭学生证）	1800 元/人	2000 元/人
CIAA 会员/个人或团体	2400 元/人	2800 元/人
普通代表	2800 元/人	3200 元/人

注 1：注册费标准**以付费日期为准**，不以注册日期为准。

注 2：进行会议报告、墙报展示和论文摘要集收录的代表**一律会前缴费**。

注 3：请登录

www.kjj.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=281&id=3598，申请成为 CIAA 个人会员（普通会员 400 元/4 年，学生会员 200 元/4 年），**享受会议费折扣优惠**。

注 4：需要退费代表，请于 **10 月 31 日前联系 CIAA 进行退费**；11 月 1 日后，不再办理退费，但会在会后寄送会议资料一套。

注 5：会议注册费统一开具增值税电子普通发票。

(2) 缴费方式

请务必先行确认本单位交费方式，以所在单位财务允许报销的方式进行交费。

(a) 微信扫码支付

登录参会人账号，扫描缴费信息页面二维码，进行缴费。

注：在线支付非常方便，可以实时到账，但收款方需要承担手续费。如果您因为不能报销而要求退款，将扣除一定手续费，且扣除的手续费不开具发票，敬请谅解。

(b) 银行汇款

请将会议相关费用汇款至大会指定账号：

户 名：北京云记科技有限公司

账 号：11050161510009100115

开户行：中国建设银行北京北太平庄支行

注：缴费后请务必将缴费凭证/截图及开票信息提交至报名系统，以便尽快确认您的缴费状态，并为您开具会议发票。

（三）酒店预订

登录参会人账号，扫描酒店预订信息页面二维码，进行酒店预订。

大会酒店预订受理截止时间为**10月31日**。在此之后不再受理房间预订，请在此日期之前登录报名系统进行预定。

七. 会议联络

（一）论文摘要投稿

王腾蛟（15901111135, iamtjwang@nwpu.edu.cn）

（二）口头报告和墙报展示

李国锋（13811710528, ligf@mail.buct.edu.cn）

（三）注册参会、赞助、展位及宣传预定等

曾雅晶（15652838082, ciaa2001@126.com）

附件 1：2026（第 7 届）抗菌科学与技术论坛部分已确定邀请报告目录

附件 2：2026（第 7 届）抗菌科学与技术论坛论文摘要模版

附件 3：2026（第 7 届）抗菌科学与技术论坛墙报模版

中关村汇智抗菌新材料产业技术创新联盟

2026年8月25日